

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/201873 A1

(51) 国際特許分類:
B65D 85/86 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/003760

(22) 国際出願日: 2022年2月1日(01.02.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-047119 2021年3月22日(22.03.2021) JP

(71) 出願人: デンカ株式会社 (DENKA COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 猪田 育佳 (INODA, Ikuka); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 谷中 亮輔 (YANAKA, Ryosuke); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 齊藤 岳史 (SAITO, Takeshi); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 園田・小林特許業務法人 (SONODA & KOBAYASHI INTELLECTUAL PROPERTY

LAW); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル34階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: RESIN SHEET FOR PACKAGING ELECTRONIC COMPONENT, AND ELECTRONIC COMPONENT PACKAGING CONTAINER USING SAME

(54) 発明の名称: 電子部品包装用樹脂シート及びそれを用いた電子部品包装容器

(57) Abstract: [Problem] To provide: a resin sheet which is for packaging an electronic component and has transparency, excellent folding endurance, and excellent low-temperature heat sealability; and an electronic component packaging container using the same. [Solution] This resin sheet for packaging an electronic component is composed of a rubber-modified aromatic vinyl copolymer resin containing a rubbery polymer (Y) as a dispersed particle in a continuous matrix resin (X) and satisfying the following (1)-(2). (1) The continuous matrix resin (X) is a copolymer of 53-63 mass% of at least one aromatic vinyl compound (x1) and 37-47 mass% of at least one alkyl (meth)acrylate (x2). (2) The proportion of the rubbery polymer (Y) is 5-10 mass% (exclusive of 10) with respect to the total mass of the rubber-modified aromatic vinyl copolymer resin.

(57) 要約: 【課題】透明性を有し、耐折強度に優れ、かつ低温ヒートシール性にも優れる電子部品包装用樹脂シート、及びそれを用いてなる電子部品包装容器の提供。【解決手段】連続マトリックス樹脂(X)中に、ゴム状重合体(Y)を分散粒子として含有し、下記(1)～(2)を満たすゴム変性芳香族ビニル系共重合体樹脂から構成されている、電子部品包装用樹脂シート; (1) 前記連続マトリックス樹脂(X)が、一種以上の芳香族ビニル系化合物(x1) 53～63質量%と、一種以上の(メタ)アクリル酸アルキルエステル(x2) 37～47質量%との共重合体であり、(2) 前記ゴム変性芳香族ビニル系共重合体樹脂の総質量に対する、前記ゴム状重合体(Y)の割合が、5質量%以上10質量%未満である。

[続葉有]

WO 2022/201873 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）